(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2005 年4 月28 日 (28.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/037888 A1

(51) 国際特許分類[7]: C08G 59/40

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015432

(22) 国際出願日: 2004 年10 月19 日 (19.10.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2003-358679
2003 年10 月20 日 (20.10.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西谷 佳典 (NISHITANI, Yoshinori) [JP/JP]; 〒3213231 栃木県宇都宮市清原工業団地２０−７ 住友ベークライト株式会社 宇都宮工場内 Tochigi (JP).

(74) 代理人: 速水 進治 (HAYAMI, Shinji); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西２−１７−１６ 代官山ＴＫビル１階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

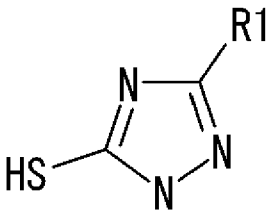
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) **Title:** EPOXY RESIN COMPOSITION AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: エポキシ樹脂組成物および半導体装置



(1)

(57) **Abstract:** Disclosed is an epoxy resin composition for sealing semiconductors which is characterized by containing (A) an epoxy resin, (B) a phenol resin, (C) a curing accelerator, (D) an inorganic filler and (E) a triazole compound. The epoxy resin composition for sealing semiconductors preferably contains a triazole compound which is represented by the following general formula (1); (wherein R1 represents a hydrogen atom, or a mercapto group, an amino group, a hydroxyl group or a hydrocarbon chain with 1-8 carbon atoms having such a functional group at the end.)

(57) 要約: （Ａ）エポキシ樹脂、（Ｂ）フェノール樹脂、（Ｃ）硬化促進剤、（Ｄ）無機質充填材および（Ｅ）トリアゾール系化合物を含むことを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物、好ましくは上記トリアゾール系化合物が一般式（１）で示される化合物である半導体封止用エポキシ樹脂組成物。［化１］ （式１）（式中、Ｒ１は水素原子、またはメルカプト基、アミノ基、水酸基もしくはそれらの官能基を末端に含む炭素数１～８の炭化水素鎖を示す。）

WO 2005/037888 A1